

湖北鼎龙控股股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20260508

| | |
|---------------------------|---|
| 投资者关系 活动类别 | <input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：“鼎龙控股集团”微信视频号直播 |
| 参与单位名称 及人员姓名 | 社会公众投资者 |
| 时间 | 2026 年 5 月 7 日晚上 19:00~19:45 |
| 地点 | “鼎龙控股集团”微信视频号直播，公司 9 楼会议室 |
| 上市公司接待 人员姓名 | 2026 年 5 月 7 日晚上 19:00~19:45：董事会秘书杨平彩女士、投资者关系总监熊亚威先生 |
| 投资者 关系活动 主要内容 介绍 | <p style="text-align: center;">公司介绍：</p> <p>公司是国内领先的关键大赛道领域中各类核心创新材料的平台型公司，主营业务横跨两大板块—半导体业务板块、锂电业务板块。现阶段，公司重点聚焦半导体创新材料业务，业务覆盖：半导体制造用 CMP 工艺材料和晶圆光刻胶、半导体显示材料、半导体先进封装材料三个细分板块，是集成电路用 CMP 抛光垫国内供应龙头，占据 OLED 新型显示材料 YPI、PSPI 国内供应领先地位，深度布局半导体 KrF/ArF 晶圆光刻胶、半导体先进封装材料等业务，新近切入新能源锂电关键功能材料领域，推动公司高速可持续发展。</p> <p style="text-align: center;">问 1：请问公司 2026 年一季度 CMP 材料业务作为核心业绩驱动，其整体营收同比显著增长的主要原因是什么？</p> <p>答：2026 年一季度，公司 CMP 材料业务作为核心业绩驱动，营收同比实现显著增长，主要原因如下：国产需求深度落地，核心客户订单饱满。公司是国内唯一全面掌握 CMP 抛光垫全流程核心技术的供应商，CMP 抛光垫国内市占率持续领先。报告期内，公司深度绑定头部晶圆厂，产品全制程适配，伴随下游存储厂商扩产，订单持续放量，一季度延续高景气度；CMP 抛光材料全品类布局成型，系统解决方案优势凸显。公司为国内唯一可配套提供 CMP 抛光垫、抛光液、清洗液的系统供应商，商业模式从单一产品供应升级为整体解决方案输出，客户粘性与单客户价值量显著提升。2026 年第一季度，抛光液及清洗液业务实现 0.85 亿元营收，新品类抛光液批量导入主流晶圆厂，贡献新增量。</p> |

公司 CMP 抛光材料产能建设匹配需求，规模化交付能力强劲。截至一季度末，武汉本部 CMP 抛光硬垫月产能达 5 万片，潜江园区抛光软垫及缓冲垫产能爬坡；仙桃抛光液产线逐步运行，产能利用率随订单增长持续提升，充分保障下游客户大规模、稳定交付需求，支撑营收快速增长；技术研发持续突破，产品性能对标国际领先，技术壁垒持续巩固。同时，与核心客户联合开发升级材料，持续打开增长空间；行业高景气延续，红利持续释放。全球半导体产业不断发展，国内晶圆厂持续扩产，CMP 材料作为芯片制造关键耗材，需求旺盛。公司凭借技术、产能、客户资源优势，充分把握行业机遇，持续提升市场份额，推动业务高速增长。

问 2：2025 年报提到 CMP 抛光垫单月销量创历史新高，能否简要说明 2026 年一季度抛光垫的产能释放情况是否持续向好？

答：2025 年公司 CMP 抛光垫单月销量突破 4 万片、创历史新高，为 2026 年一季度持续高增奠定了坚实基础。2026 年一季度，公司抛光垫产能释放延续向好态势，核心产能与交付能力持续强化：

硬垫产能如期达峰，规模优势显著。截至 2026 年一季度末，武汉本部 CMP 抛光硬垫月产能已提升至 5 万片（年产约 60 万片），较上年同期稳步扩容，产能利用率随核心客户订单饱满持续走高，充分匹配下游头部晶圆厂扩产节奏，保障大规模稳定交付；软垫产能良性爬坡，配套能力增强。潜江园区年产 20 万片抛光软垫及配套缓冲垫产能持续释放，产线良率与订单转化率稳步提升，精准适配全制程精抛环节需求，与硬垫形成全品类协同，进一步巩固全链条供应优势；产能规划前瞻落地，增长后劲充足。武汉“光电半导体材料研发制造中心项目”有序推进，达产后将新增年产 40 万片大硅片抛光垫产能，持续完善产能布局，为后续国产替代深化与市场份额提升筑牢产能根基。

2026 年一季度公司抛光垫产能释放态势良好，产能规模、利用率及配套能力均处于行业领先水平，有效支撑业绩持续高增，核心龙头地位持续夯实。

问 3：请问公司本次耗材业务剥离，剥离后对公司整体营收结构有何影响？

答：本次剥离通用打印耗材终端业务，是公司聚焦半导体材料核心主业、优化营收结构与提升盈利质量的重大战略举措，剥离后公司营收结构将发生显著优化，具体影响如下：①主业聚焦度大幅提升，营收结构更趋精简高效。本次剥离后，公司营收将主要来源于半导体材料（CMP 抛光材料、半导体显示材料、光刻胶、先进封装材料等）及新能源锂电功能性辅材等高增长业务，主业聚焦度显著增强，营收结构更清晰。②半导体核心业务占比进一步提高，业绩驱动更加集中。剥离完成后，半导体材料业务在公司合并营收中占比将大幅提升，业绩驱动更加集中、增长逻辑更清晰。③盈利质量与抗风险能力显著增强；同时，公司回收近 4.4 亿元现金，可集中投入半导体材料产能建设、技术研发及新款产品验证，进一步强化核心业务竞争力，为长期高质量增长奠定坚实基础。④资源配置持续优化，高增长赛道投入力度加大，加速核心业务成长，持续提升公司在中国半导体材料产业中的龙头地位。

本次打印耗材终端业务剥离，不仅是营收结构的调整，更是公司战略聚

焦、提质增效、强化核心竞争力的关键一步，将推动公司从“传统耗材 + 半导体材料”的多元布局，彻底转型为专注半导体材料及创新材料的平台型企业，营收结构更优、盈利质量更高、增长动能更强，长期发展潜力进一步释放。

问 4：本次皓飞收购事项，公司预计后续会产生哪些协同效应，对短期业绩是否有积极影响？

答：本次收购皓飞新材 70% 股权，是公司落实“创新材料平台型企业”战略、打造第二增长曲线的重要布局，收购完成后将在技术、客户、产能、财务等多维度形成显著协同：

技术协同：高分子材料技术同源，研发效能倍增。公司在半导体材料领域积累的高分子合成等核心技术，与皓飞新材锂电粘结剂、分散剂的研发高度同源，可实现技术复用与交叉赋能。双方将联合开发并加速产品迭代与性能升级，同时共享研发平台与人才资源，降低研发成本、缩短验证周期，巩固技术壁垒。

客户协同：双赛道优质客户互补，资源共享增效。皓飞新材深度绑定国内头部动力电池及储能电池厂商，公司可借助皓飞新材的锂电客户资源，实现半导体材料与新能源材料客户的交叉渗透；同时依托公司在半导体领域的头部客户服务能力与品牌影响力，助力皓飞新材进一步拓展市场。

产能与供应链协同：规模化优势互补，交付能力强化。公司具备成熟的材料生产基地与供应链管理体系，可与皓飞新材现有产能形成互补，通过共享采购渠道、优化生产排产、提升良率等方式，降低生产成本、增强规模化交付能力。

财务协同：并表增厚业绩。皓飞新材经营状况良好、盈利能力较强，2026 年一季度实现营收 1.57 亿元，同比增长 40.75%，自 3 月起纳入公司合并报表范围。本次收购完成后，皓飞新材将成为公司控股子公司，其营收与利润将按持股比例并入公司报表，直接增厚公司整体业绩。

战略协同：构建“半导体 + 新能源”双轮驱动。本次收购标志着公司正式切入新能源锂电材料赛道，形成“半导体材料为核心、新能源材料为增长第二曲线”的战略格局，提升公司长期发展韧性与估值空间。

问 5：请问公司已具备充足的抛光液产能储备，近期三款抛光液产品获得突破后，产能利用率是否有明显提升？

答：公司抛光液业务已构建充足产能储备，仙桃园区万吨级抛光液及配套纳米研磨粒子产线逐步稳定运行，武汉本部产能协同配套，可充分满足多品类产品规模化交付需求。近期大硅片精抛液、氧化铈抛光液、先进封装 TSV 抛光液三款产品接连实现技术突破并斩获批量订单，有助于驱动产能利用率进一步提升。

产能方面，新品突破带动订单放量，有助于持续提升产能利用率。本次三款高端抛光液产品同步实现国产化突破，切入 12 英寸大硅片制造、龙头存储芯片、先进封装三大高壁垒赛道，均获得核心客户批量订单并启动规模化供货。

同时，全品类布局优化产能结构，运营效率持续改善。三款新品突破后，

| | |
|------|---|
| | <p>公司抛光液已覆盖铜制程、钨制程、大硅片精抛、氧化铈、先进封装 TSV 等全制程品类，产品矩阵进一步完善。依托现有万吨级产能平台，实现多品类产品高效生产，产品盈利空间持续扩大。除此之外，自研磨料配套赋能，产能释放根基稳固。公司同步配套建设纳米研磨粒子产线，实现氧化硅、氧化铈、氧化铝等核心磨料自研自产，保障抛光液生产核心物料稳定供应，避免外部采购制约产能释放。三款新品所需核心磨料均已实现自主制备，可快速匹配新增订单产能需求，推动产能利用率稳步攀升的同时，为后续持续扩产、承接更大规模订单提供坚实支撑。</p> <p>公司抛光液产能储备充足，三款新品突破后订单有望持续放量，产能结构持续优化，规模效应与盈利优势同步凸显。后续随着高端产品渗透率持续提高，产能利用率有望进一步提升，为公司 CMP 材料业务持续高增长提供坚实产能保障。</p> <p>问 6：请问当前抛光液产品的产能储备，能否满足后续新增订单及规模化供应的需求？</p> <p>答：公司目前抛光液板块已搭建完善且储备充裕的产能体系，武汉本部与仙桃园区量产产线运行稳定、布局合理，同时配套建成纳米研磨粒子等核心原料自研自产产线，实现关键耗材供应链自主制备、保障能力坚实可靠。随着公司三款高端抛光液产品相继取得技术突破并顺利导入头部客户实现批量供货，现有产线产能利用率持续稳步提升，当前整体产能仍保留充足富余空间，可快速响应不同制程、不同应用领域的新增订单需求。此外公司生产基地已提前预留完备的厂房场地、公用工程及配套设施，具备快速改扩建、短期释放新增产能的弹性空间，能够根据下游晶圆厂扩产进度、国产化替代节奏以及客户订单放量情况，灵活推进产能爬坡与阶段性扩产规划。综合来看，公司当前既有成熟量产产能作为基础支撑，又有富余产能承接即时新增订单，更有预留扩容空间匹配中长期行业增量，整体产能储备、交付保障能力与远期扩容潜力，完全可以充分满足后续持续新增订单落地以及长期大批量、规模化稳定供货的市场需求，为公司抛光液业务持续放量、巩固行业龙头地位提供稳固产能基石。</p> |
| 附件清单 | 无 |
| 日期 | 2026 年 5 月 7 日 |